

2024  
2025  
年度版

# 半導体産業 計画総覧

AI市場が盛り上がり、  
クラウドからエッジまで半導体需要牽引

- GPUやHBMなどAI用半導体が絶好調
- 中国投資は依然活況、装置需要を牽引
- 日本国内も大型工場投資計画が進行中
- インドでも半導体産業が本格的な産声
- パワー半導体はSiC・シリコンともに高水準投資
- 車載半導体は電動化・知能化がドライバーに
- 国内半導体主要各社の最新売上・投資計画を集計

自動車向けセンサー好調

# (株)芝浦電子

【本社】〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-1-24 Tel.048-615-4000

【代表者】葛西 晃

【資本金】21億4461万円

## 23年度は減収減益

22年度(23年3月期)の売上高は306億1200万円(前年同期比8.4%増)、営業利益は54億6000万円(同2.0%減)の増収減益だった。売上高は増えたが、粗利益率が前年同期から1.8ポイント悪化(27.6%)したほか、ロックダウンによる上海工場停止の影響や原材料価格の上昇など経費が増加したことで減益となった。

23年度の売上高は324億100万円(前年同期比2.4%減)、営業利益は51億400万円(同6.5%減)の減収減益だった。粗利益率が前年同期から0.3ポ

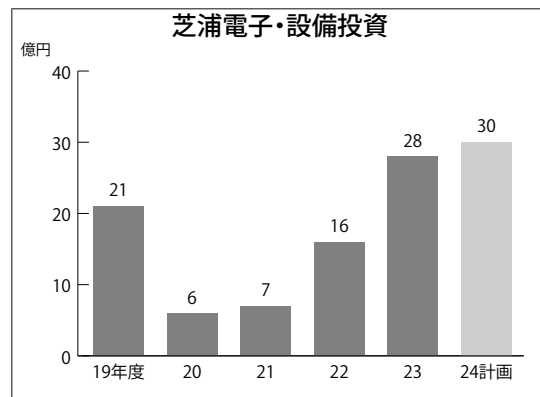
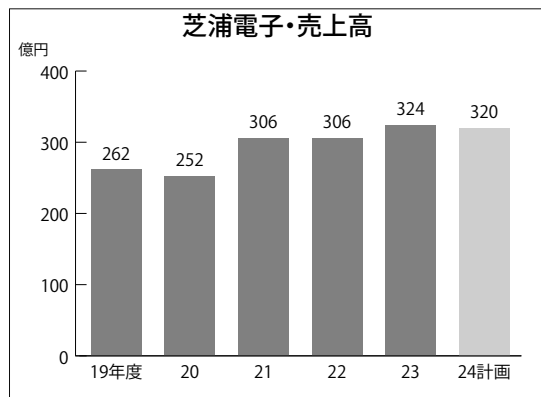
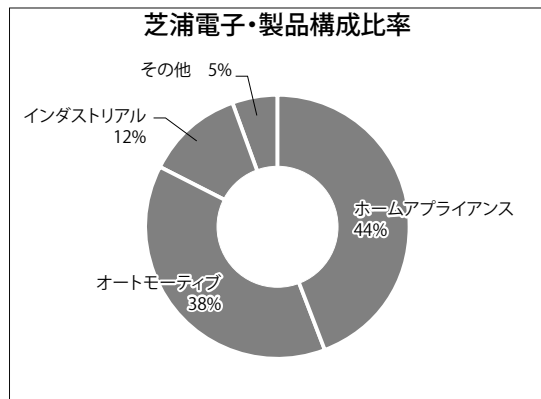
イント改善(27.9%)したが、売上高が減少し、販管費が増加したことで減益となった。

事業別の売上高はホームアプライアンス(空調、家電、住設機器)が143億5800万円(前年同期比6.7%減)、オートモティブ(自動車)が124億2400万円(同15.1%増)、インダストリアル(OA、産業機器)が39億2700万円(同17.6%減)となっている。

ホームアプライアンスでは、エアコン向けセンサーの落ち込みが続き、ガス給湯器などの住宅設備向けセンサーの販売も減少した。オートモティブについては、電動化の推進などで、EV

320億円(前年同期比1.2%減)、営業利益48億円(同6.0%減)を計画している。中期経営計画達成に向けて、研究開発体制および製品開発を強化するなど、温度センサー分野でのシェア拡大に向けた積極的な事業展開を進める。

具体的には、EV/HVのシェアを拡大するほか、環境規制やエネルギー効率化に関わる様々な分野への展開を加速するほか、海外市場での売上拡大を図る。また、安定した製品供給や利益を獲得するため、製造工程の効率化推進など、生産性の向上に取り組む。さらに、今後の受注増加に対応するため、生産設備の増強投資を進める。



## 設備投資を拡大

同社は経営環境の変化に柔軟に対応するため、ローリング方式で中期経営計画を毎年策定している。長期経営構想では、24~33年度までの10年間で3つの期間に分け、フェーズ1では成長基盤の整備、フェーズ2では成長基盤の確立、そして、フェーズ3ではさらなる

24年度通期の業績については、売上高

同社は経営環境の変化に柔軟に対応するため、ローリング方式で中期経営計画を毎年策定している。長期経営構想では、24~33年度までの10年間で3つの期間に分け、フェーズ1では成長基盤の整備、フェーズ2では成長基盤の確立、そして、フェーズ3ではさらなる

## 半導体パッケージ基板事業を重視

## LG イノテック

LG Innotek

【本社】韓国ソウル市江西区麻谷中央10路30、Tel.+82-2-3777-1114 代表取締役社長 ムン・ヒョクス  
 【日本法人】〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー 12階 Tel.03-5299-9250

## ハイエンド半導体向けFC-BGAに集中

LGグループ傘下のLGイノテックは、組織改編を通して基板素材事業部の位置づけを引き上げ、事業部長の肩書は従来の専務から副社長クラスに格上げした。同社が基板素材事業部長を唯一、副社長クラスにしたのは、新事業の半導体パッケージ基板事業を重視しているからであろう。同社は、カメラモジュールなどを手がける光学ソリューション事業部への高い依存度を改善し、次世代ビジネスを育成するためにPCB基板事業を強化している。2023年7～9月期基準でLGイノテックの総売上高のうち、光学ソリューション事業部が占める割合は80.7%と、非常に偏っていることが分かる。したがって、ニュービジネスに対する必要性が指摘されてきた。

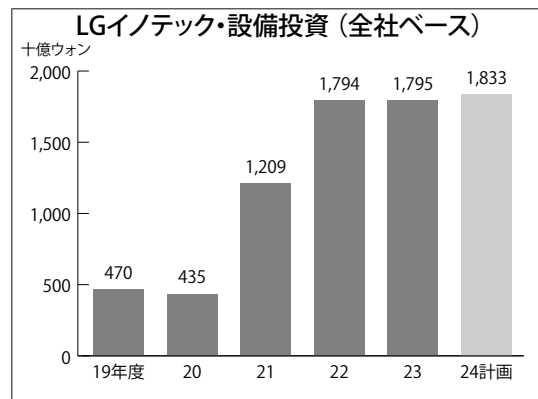
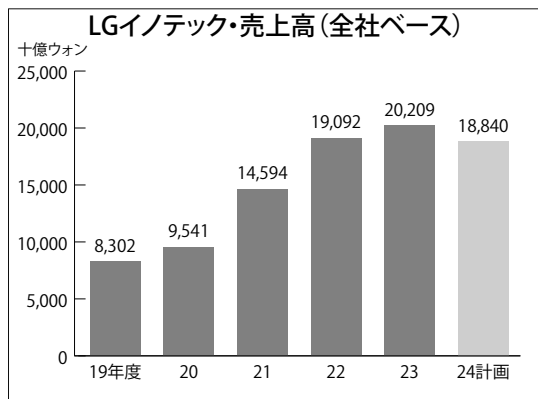
今後、基板事業で集中する分野はFC-BGA（フリップチップ・ボールグリッドアレイ）である。FC-BGAは、半導体チップとメーン基板を連結する高密度の回路基板で、HPC（高性能コンピ

ューティング）などといったハイエンド半導体に使われている。近年、人工知能（AI）とビッグデータの拡大により、その需要が増加しつつある。こうした市場状況を踏まえて同社は、韓国亀尾（グミ）にFC-BGAラインを建設するため4130億ウォン（約486億円）を投じている。また、今後もキャパシティー増大のために段階的に増設していく計画だ。23年6月にFC-BGAの量産に踏み切っており、同年末に追加の量産を断行した。LGイノテックの経営陣はFC-BGA事業の重要性を強調し、最近の半導体パッケージング懇親会において「かつての数期間は光学ソリューション分野に集中してきたが、FC-BGAと自動車向けの部品に集中しており、24年から目に見える成果が出てくる見通しだ」と述べている。

## アップルの独禁法訴訟で韓国メーカーに影響も

米司法省は24年3月、アップルを相手取り独占禁止法（反トラスト法）違

反の訴訟を起こした。欧州連合（EU）のデジタル市場法（DMA）に続く米国での制裁により、同社の株価は1日で4%（1130億ドル）以上も下落した。5年間の捜査を経て提訴された本件は、iPhoneをはじめ、ノートパソコン、タブレット、スマートウォッチなど独自機器を通して構築したアップルの「閉鎖的なエコシステム」の問題点を真正面から狙ったものである。つまり、アップルは他のスマートフォン（スマホ）で作動する「スーパーアプリ（多様なサービスが可能なアプリ）」をiPhoneでは動作しないようにした。米司法省はこれを「アップルの反トラスト法違反で消費者の負担が増えた」と非難した。iPhoneは米国市場で50%以上のシェアを占めている。EUは24年3月初頭、アップルが優越的な立場を利用して公正競争を制限したとして18億4000万ユーロ（約3146億円）の課徴金を賦課した。また、アップルの手数料政策および利用約款がDMAの規定を遵守しているか調査する方針だ。仮に、アップルが義務を履行しなかったとされた



## EMSなど多角的展開で売上1兆円目指すエレクトロニクス総合商社

## 加賀電子(株)

【本社】〒101-8629 東京都千代田区神田松永町20 Tel.03-5657-0111

【代表者】門良一

【資本金】121億3300万円

## 24年度売上高は5550億円計画

2024年度（25年3月期）の業績として、売上高が前年度比2%増の5550億円、営業利益が同0.6%増の260億円を計画している。このうち、電子部品事業の売上高は同2%増の4825億円、セグメント利益は同ほぼ横ばいの209億円を見込む。

会社別の売上高では、エクセルが大口取引の喪失によって前年度から減少し約300億円となる見通し。加賀電子は同微増の3250億円、加賀FEIも同微増の2000億円と予想。営業利益は3社とも前年度比増益見込みで、加賀電子198億円、加賀FEI47億円、エクセル15億円と予想する。

加賀FEIの売上高予想2000億円のうち、ソシオネクスト製品販売分は前年度比5%増の約840億円を見通しており、このうち日本が前年度並みの約560億円、次いで北米、アジアが続くと見込む。

24年度は、車載向けを中心とする中長期的な市場成長を見込むシナリオは変わらないとするが、EMSで空調を中心とする顧客での在庫調整が当面継続すると見通し、本格的な需要回復は下期になるとみている。また、23年度末に期末在庫は547億円まで改善したが、まだ目標の500億円以下には未達として「引き続き、期末在庫500億円以下、在庫回転日数30日の目標達成に取り組む」（門良一社長）とする。

23年度業績は、売上高が前年度比11%減の4527億円、営業利益は同20%

減の258億円だった。電子部品事業でのスポット需要消失や下期以降の在庫調整本格化などが響いた。

## EMSで28年売上3000億円超目標

EMS（電子機器の受託製造サービス）事業の拡大を前面に押し出している。2028年には現行の2倍超となる売上高3000億円超を掲げ、本業である電子部品商社機能との相乗効果を最大限発揮する。

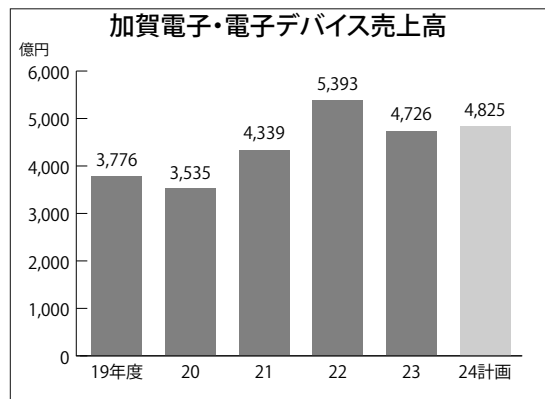
23年度のEMS事業は、車載向けが伸長した一方、医療機器・産業機器向けが弱含み、23年度同期は売上高が前年度比20%減の1205億円、営業利益は同23%減の73.8億円と減収減益の決算となった。24年度は後半に顧客先の在庫調整も進むとみて、再び増収増益を見通す。

EMSを取り巻くマクロ環境では、米中の経済摩擦の影響で中国でのものづくりが難しくなっており、ベトナムなどASEANでの製造比率が高まるとみる。特にベトナムには注目しており、ハノイやホーチミンに生産子会社を設立。香港にある調達部門とも連携して、同国での事業活動を3年以内には大きく飛躍させたいとする。一方、中国の潜在力は高くサプライチェーンも完成している。中国でのビジネスをさらに拡大するべく注力し

ていく方針だ。

同社の今後のEMS事業の方向性としては、「中国×日本」のものづくりの掛けあわせで考えている。中国の安くて豊富な部材をベースに、日本ならではの高品質なものづくり力を積極的に活用して、これをグローバルに展開する。今後、新たな地政学的な問題が生じた際にも、従来の中国一辺倒のものづくりにこだわらず、チャイナプラスワンを実現するため、マレーシアなどでもその仕組みを築き上げる。つまり、中国並みの低コストで日本品質のものづくりを3年以内には実現すべく取り組んでいく。

前述の28年3月期売上高3000億円の目標達成に向けては、国内を含めてASEANや欧米など、消費地に近いところで生産する傾向が強くなってきている流れを捉え、EV/HVなどの電動車関連をはじめ、産業機器や医療機器向けなどの受託製造も一層広げていく。





書名 .....半導体産業計画総覧 2024-2025 年度版  
体裁・頁数 .....A4 変形判、600 頁  
定価 .....33,000 円 (税込)  
発刊日 .....2024 年 9 月 17 日